

## EMI-TIIVISTEMASSAT

### EMI-Tiiviste



#### PARKER TECKNIT 0002 EMI-Gasket



- Sähköä johtavat tiivistemateriaalit
- Suunniteltu käytettäväksi sähköä johtavana gap-fillerinä tai esimerkiksi maadoittavana kotelon tiivisteenä
- Pursotettava

### TUOTEKUVAUS

[Linkki valmistajan sivuille](#)

Tuote	Selite	Käyttökohde
TECKNIT 0002	Hopeapohjainen sähköä johtava ja nopeasti kovettava 1-komponentti silikonitiiviste	Elektroniikan koteloiden EMI-suojaukseen tai maadoittamiseen
TECKNIT 0005	Hopeapinnoitettua lasia sisältävä sähköä johtava 1-komponentti polyolefiiniitiiviste	Suunniteltu säilyttämään joustavuus, ja tarkoitettu erityisesti kohteille jotka täytyy olla purettavissa
CHO-BOND® 4669	Hopeapinnoitettua kuparia sisältävä sähköä johtava 1-komponentti polyisobuteeniitiiviste	Suunniteltu erityisesti applikaatioihin joissa vaaditaan tärinänkestoa
CHO-BOND® 1016	Nikkelipinnoitettua grafiittia sisältävä sähköä johtava 1-komponentti silikonitiiviste	Galvaanista korroosiota ehkäisevä lopputulos alumiinin kanssa
CHO-BOND® 1035	Hopeapinnoitettua lasia sisältävä sähköä johtava 1-komponentti silikonitiiviste	Kevyt EMI-suojaus kuluttaja, ja militariapplikaatioihin
CHO-BOND® 1038	Hopeapinnoitettua kuparia sisältävä sähköä johtava 1-komponentti silikonitiiviste	Gap filleri EMI-suojaukseen tai maadoitukseen
CHO-BOND® 1075	Hopeapinnoitettua alumiinia sisältävä sähköä johtava 1-komponentti silikonitiiviste	Erinomainen suojaus, ja galvaanista korroosiota ehkäisevä lopputulos alumiinin kanssa
CHO-BOND® 1121	VOC-vapaa hopeapinnoitettua kuparia sisältävä sähköä johtava 1-komponentti silikoni	Gap filleri EMI-suojaukseen tai maadoitukseen
CHO-BOND® 2165	Stabiloitua kuparia sisältävä sähköä johtava 2-komponentti polyuretaani	Korroosionkestävä lopputulos ilmailu ja militärikäyttöön
CHO-BOND® 4660	Hopeapinnoitettua kuparia sisältävä sähköä johtava 1-komponentti polyisobuteeniitiiviste	Suunniteltu erityisesti applikaatioihin joissa vaaditaan tärinänkestoa
CHO-BOND® 1019	Hopeapinnoitettua alumiinia sisältävä sähköä johtava 2-komponentti silikonitiiviste	Gap filleri/saumasaine militärikäytön EMI-suojaukseen tai elektroniikan kotelolle
CHO-BOND® 1077	Nikkelipinnoitettua alumiinia sisältävä sähköä johtava 1-komponentti silikonitiiviste	Gap-filleri tai saumasaine elektroniikkakoteloiden EMI-suojaukseen
PRO-SHIELD® 7002	Nikkelipinnoitettua grafiittia sisältävä silikonitiiviste	Helppokäyttöinen gap-filleri horisontaali, ja vertikaalipinnoille

PRO-SHIELD® 7008	Hopeapohjainen silikonitiiviste	Gap-filleri applikaatioihin joissa vaaditaan maksimaalista EMI-suojausta
------------------	---------------------------------	--

Löydät em. tuotteiden datalehdet sivun alareunasta Tiedostot-osiosta.

## TEKNISET TIEDOT

<b>Kovetusaika (Full)</b>	72 h
<b>Kovetusaika (Tack free)</b>	120 min
<b>Kovetustapa</b>	Kosteus
<b>Kovuus</b>	51 Shore A
<b>Käyttölämpötila</b>	- 59°C to 204°C
<b>Materiaali</b>	Silikoni
<b>Ominaisvastus</b>	0.010 ohm-cm
<b>Säilyvyys</b>	5,5 kuukausi
<b>Työaika</b>	5 min
<b>Täyteaine</b>	Hopea
<b>Varastointilämpötila</b>	25°C